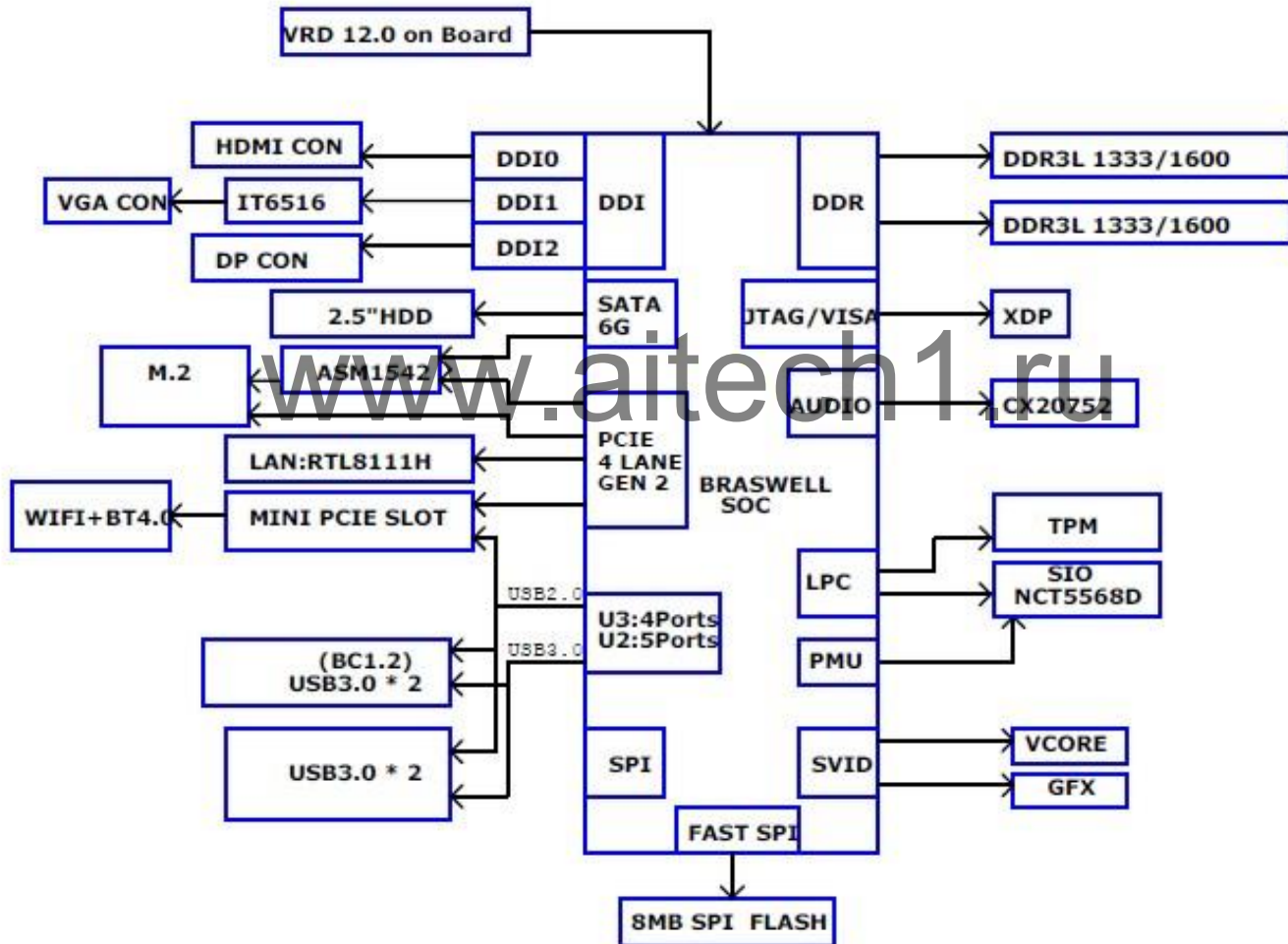


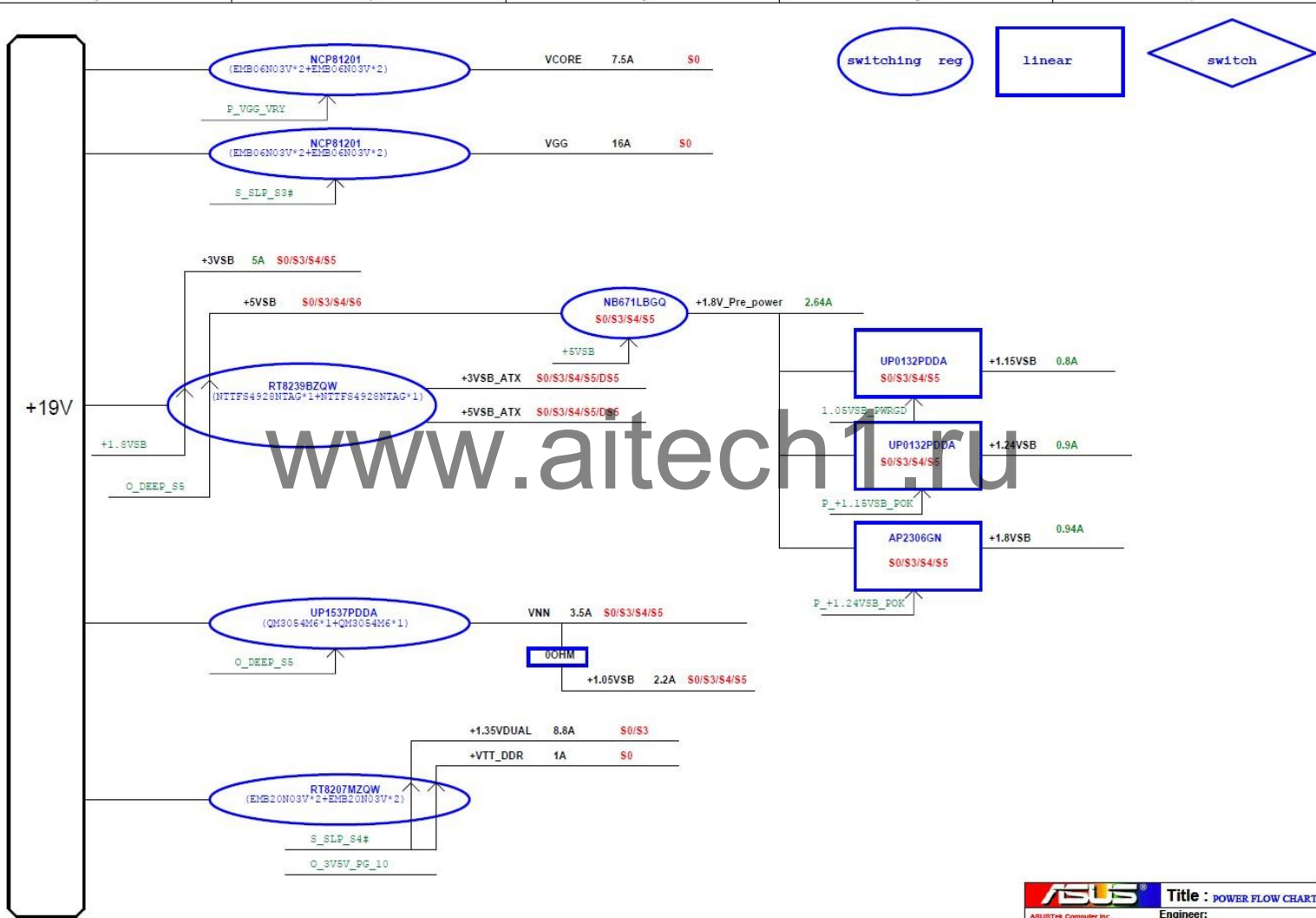
UN45 Repair Guide

2015/10/23
Larry1_Chen

BLOCK DIAGRAM

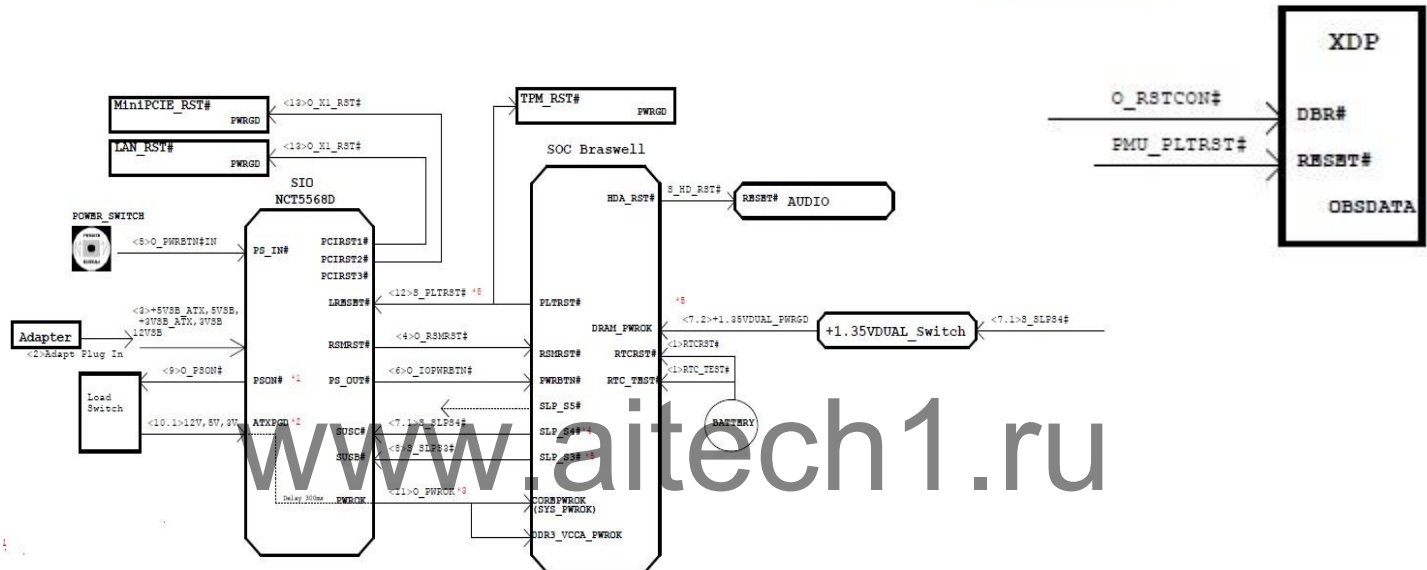


POWER FLOW



POWER ON SEQUENCE

RESET_SWITCH



PS_ON# is inverted by SLP_S3#, but gated and delayed by FWRKTH#

FWRK will assert when +3V arrives at +2.1V then delay 300ms-500ms and gated by ATXPGD

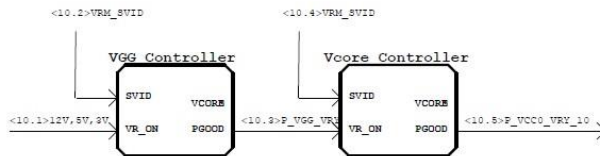
VTT_DDR stable to DDR3_VCCA_FWRK and PNC_CORE_FWRK assertion NO PCIe* devices-----min 10ms power rails needed by PCIe* devices-----min 90ms

SLP_S4# controls +1.35VDual and +VTTDDR

Come with 1.35VDUAL

PLTRST# = PCH_FWRK "AND" PCH_SYS_FWRK

PLTRST_PROG# = PLTRST#, voltage=1V, directly connect to CPU



BGA Reflow Profile

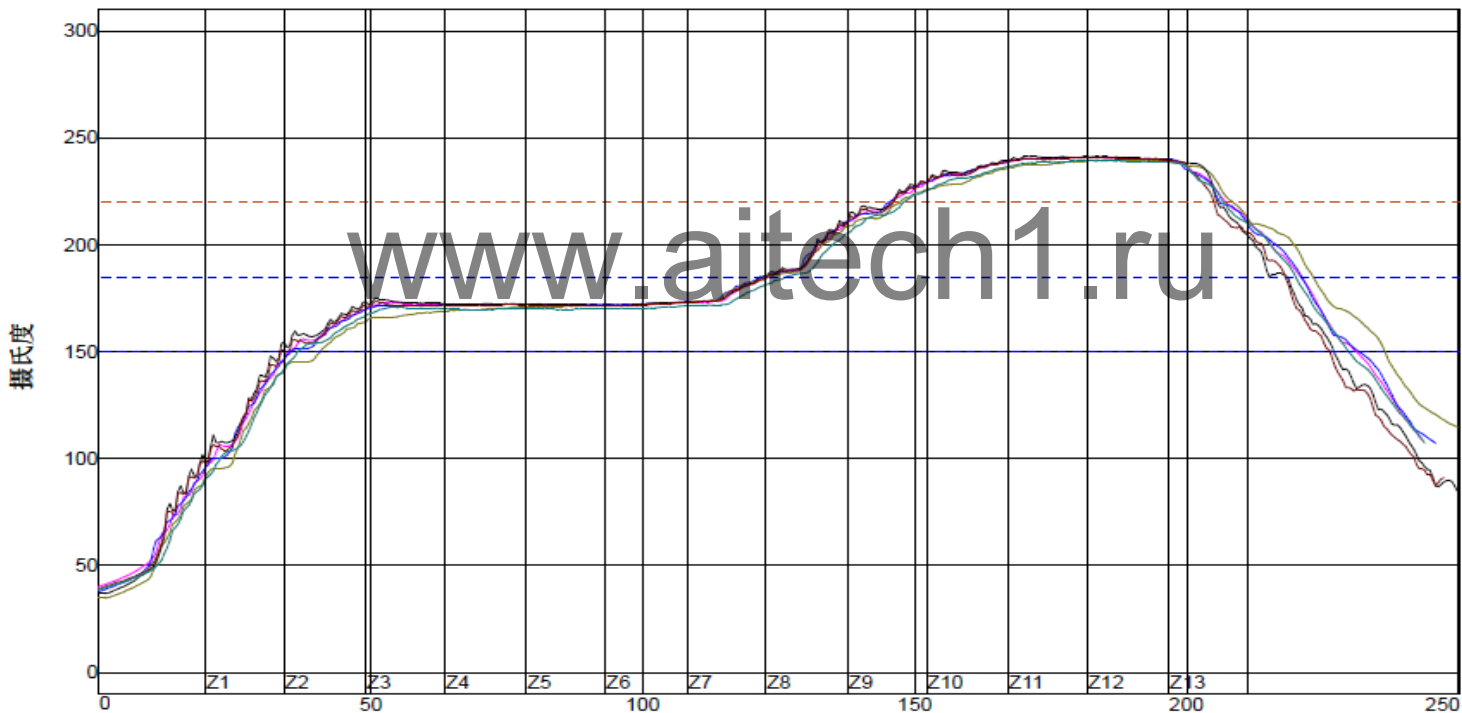
炉子名称: Rehm(13 Zones)

制程界限名称: PF606-P,

会审者:

温度设置 (摄氏度)

温区	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
上温区	170	200	190	170	170	170	180	200	245	245	250	245	240
下温区	170	200	190	170	170	170	180	200	245	245	250	245	240
传送带速度 (毫米/分)	1400.00												



PWI= 63%		最高上升斜率		最高下降斜率		恒温时间150至185C		回流时间 /220C		最高温度		总共 时间 /220C	
U16		3.02	35%	-3.08	-38%	87.57	-8%	61.65	44%	240.90	45%	61.65	44%
U20		3.05	37%	-2.99	-32%	86.52	-12%	60.69	38%	241.17	49%	60.69	38%
U6		3.05	36%	-2.78	-18%	82.78	-24%	61.14	41%	239.51	27%	61.14	41%
U9		3.20	47%	-3.44	-63%	89.05	-3%	59.87	32%	241.61	55%	59.87	32%
U12		3.11	41%	-3.35	-57%	88.85	-4%	58.90	26%	240.88	45%	58.90	26%
CN17		3.00	33%	-3.04	-36%	89.67	-1%	58.88	26%	239.56	27%	58.88	26%
温差		0.20		0.66		6.89		2.77		2.10		2.77	

制程界限:

锡膏:	PF606-P,	会审者:	
统计数名称	最低界限	最高界限	单位
最高温度上升斜率 (目标=2.5)	1	4	度/秒
(计算斜率的时间距离= 40 秒)			
最高温度下降斜率	-4	-1	度/秒
(计算斜率的时间距离= 40 秒)			
恒温时间150-185摄氏度	60	120	秒
回流以上时间 - 220摄氏度	40	70	秒
最高温度	230	245	度 摄氏度
在220摄氏度以上时间	40	70	秒

BGA Baking time

BGA roasted conditions: 120 °C, 8 hours